

证券代码：300456

证券简称：赛微电子

## 北京赛微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-006

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	平安资管 王晶      国信证券 连欣然
时间	2024年6月28日 10:00-12:00
地点	北京经济技术开发区科创八街21号院 赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司 205 会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、财务总监：张阿斌 证券事务代表：孙玉华 证券投关经理：刘妍君 证券事务助理：甘世延、林彦凌
投资者关系活动主要内容介绍	<b>第一部分：公司介绍及工厂参观</b> 上市公司介绍了公司的基本情况、发展历程、核心业务、产业角色、全球化布局、发展战略、商业模式、竞争格局等。在经历重大战略转型后，赛微电子已专注 MEMS 芯片制造主业，当前核心工作就是持续提升境内外产线的产能、利用率及良率，公司看好智能传感行业的未来发展空间，同时对自身的芯片制造工艺及综合竞争实力充满信心。  公司组织安排了北京 FAB3 产线洁净间参观活动。

**第二部分：上市公司解答提问，主要如下：**

**1、请问公司如何看待 MEMS 的市场规模？**

答：随着万物互联与智能传感时代的到来，物理世界与数字世界需要相互连接的桥梁，无论科技及应用如何发展，均离不开对真实世界的感知，人、设备、自然世界之间及内部各自之间的感知、联系均需要通过声、热、光、电、磁、运动等等各种基础器件来辅助实现，基础感知及执行器件的应用场景将越来越丰富，通过半导体工艺批量标准化制造的 MEMS 芯片，具备小型化、低成本、低功耗、高集成度等突出特点，正在对部分传统传感器件进行渗透及替代，拥有良好的发展前景。

根据 Yole Development 的研究预测，全球 MEMS 行业市场规模将从 2021 年的 136 亿美元增长至 2027 年的约 223 亿美元，复合增长率（CAGR）达 9%，通讯、生物医疗、工业汽车及消费电子的应用增速均非常可观，其中通讯领域的复合增长率高达 25%。预计到 2026 年，10 亿美元以上的 MEMS 细分领域包括射频 MEMS（40.49 亿美元）、MEMS 惯性器件（40.02 亿美元）、压力 MEMS（23.62 亿美元）、麦克风（18.71 亿美元）以及未来应用（13.63 亿美元）。

由于公司自身 MEMS 业务突出的竞争优势，近年来所取得的复合增长率远远超过了行业平均增速，这也是我们持续扩充产能的信心来源，希望能通过新增产能与市场需求相结合，将公司所积累的工艺优势充分发挥出来。作为一家具备全球一流水平的专业芯片制造厂商，我们需要做的是持续不断地丰富和提升芯片制造工艺水平、持续不断地在全球范围内扩充中试及规模产能，顺应万物互联与人工智能时代的发展及需求爆发。

**2、请介绍北京 Fab3 的产品结构、产能利用率、产能建设规划。**

答：公司北京 FAB3 基于自主基础核心工艺，持续开拓消费电

子、工业汽车、通信、生物医疗等各领域的客户及 MEMS 晶圆类别，尤其是具备量产潜力的领域及产品。产线运营初期时，北京 FAB3 的产品结构侧重于消费电子，后续向其他领域拓展，截至目前已实现硅麦克风、BAW 滤波器、微振镜等的量产，正在尽快推进惯性加速度计、惯性 IMU、压力、温湿度、基因测序、硅光子、微流控、气体、振荡器等 MEMS 传感器件的风险试产及量产进程，业务及产品结构将随之动态变化。与此同时，北京 FAB3 将持续提升产能及工艺能力，持续拓展新的市场及产品领域。

2023 年，北京 FAB3 的产能利用率为 13.80%，产能爬坡在 2023 年第四季度较为快速，2023 年 12 月单月产能利用率已达 24.07%，但由于产能持续扩充，全年产能利用率仍处于较低水平。北京 FAB3 积极推动不同类别、不同型号产品的工艺开发、产品验证及量产进程，持续推动产线的产能爬坡，2024 年初以来的产能利用率已实现继续提升。

北京 FAB3 已建成并运转一期产能为 1.2 万片/月，其中包括了公司与武汉敏声合作建设的 BAW 滤波器专线。同时，北京 FAB3 正在持续推进建设二期剩余产能 1.8 万片/月的建设。

### **3、请问公司如何展望瑞典 Sillex 未来的产能利用率、未来的业绩？**

答：瑞典产线一方面积极推动已有 8 英寸产线的产能利用率爬坡，另一方面也在积极新建 12 寸产线，将逐步形成从中试到量产的衔接服务能力，从而持续提高产能利用率。

2023 年，瑞典 Sillex 的业务情况已经恢复至正常水平，挖掘现有产线产能潜力的同时，也正在布局 12 英寸产线，积极服务市场需求。基于对下游应用市场需求增长的预期，瑞典 Sillex 认为其业绩在未来将持续保持增长。瑞典 Sillex 近期刚推出的认股权证计划，也反映了子公司及其核心团队对未来业

务发展的信心。

**4、请问公司 MEMS 业务收入是否受到季节性、淡旺季的影响？**

答：根据公司历史统计数据，MEMS 业务收入的季节性、淡旺季并不明显。虽然不同季节会因所交付芯片晶圆的结构差异而产生波动，但由于偏居上游，涉及下游各行业较为分散，来自不同领域的需求增减会在一定程度上相互抵消，因此 MEMS 业务的周期性较弱。

**5、公司如何看待 MEMS 行业的纯代工模式及 IDM 模式？**

答：在我们看来，每家公司的业务发展模式都是根据自身的业务情况确定的，公司非常尊重各类厂商（包括客户）自身的战略考虑。但同时我们也应看到，半导体制造产线的建设具有长周期、重资产投入的特点，且某单一领域设计公司投资建设的自有产线一方面较难为同类竞争设计公司服务，另一方面产线向其他产品品类拓展的难度也较大。而公司是专业的纯代工企业，基于长期的工艺开发及生产实践，在同类产品的代工业务方面能够积累较好的工艺技术，在制造环节具有产品迭代和成本控制方面的服务优势，Fabless（无晶圆厂）模式或 Fablite（轻晶圆厂）设计公司与我们合作，可以避免巨大的固定资产投资，可以将资源更多地专注在产品设计及迭代方面，并参与市场竞争。

公司的商业模式为纯 MEMS 代工厂商，根据客户提供的 MEMS 芯片设计方案，进行优化反馈、工艺制程开发以及提供完整的 MEMS 芯片制造服务，公司及子公司在过去 20 多年已在行业内树立了不涉足芯片设计、无自有品牌、专注工艺开发及晶圆代工、严密保护知识产权的企业形象，最大程度地避免了因与客户业务冲突导致出现 IP 侵权的道德及法律风险，增加了客户的认同感及信任度。客观而言，从过去到未来，大量

Fabless（无晶圆厂）或 Fablite（轻晶圆厂）设计公司出于对自身 MEMS 专利技术保护的考虑，倾向于将其 MEMS 生产环节委托给纯代工厂商，也反映了专业分工的趋势，台积电（TSMC）所获得的巨大成功也是半导体专业分工趋势的例证和参考。

综合而言，IDM 模式与 Fabless 或 Fablite 模式（对应与纯 Foundry 厂商合作）相比各有优劣，将会是业界长期共存的商业发展模式。

**6、请问公司与境内其他 MEMS 厂商相比，业务上是否存在差异性，竞争优势和劣势有哪些？**

答：在当前竞争格局下，公司在 MEMS 芯片工艺开发及晶圆制造方面已经深耕超过二十年，存在着显著的竞争优势，主要如下：（1）突出的全球市场竞争地位；（2）先进的制造及工艺技术，掌握了多项在业内极具竞争力的工艺技术和工艺模块；（3）标准化、结构化的工艺模块；（4）覆盖广泛、积累丰富的开发及代工经验；（5）产业长期沉淀、优秀且稳定的人才团队；（6）丰富的知识产权；（7）中立的纯晶圆厂模式；（8）前瞻布局、陆续实现的规模产能与供应能力。

公司截至目前的劣势也较为明显，即整体产能及营收规模较小，短期内尚缺乏规模效应，工艺优势尚未得到完全发挥和体现，境内产线团队仍需要通过量产实践加以磨练。相比其他排名领先的代工厂商以及中国境内的新兴厂商，虽然瑞典 Fab1&2 与北京 Fab3 到目前为止尚未充分展现规模量产能力，但在 MEMS 工艺技术的广度及深度方面，以及产品及客户积累等方面，均能体现出巨大的、待释放的发展潜力。当然中国境内外的许多 MEMS 厂商也非常优秀、具备不同的特点，且由于整个 MEMS 产业仍处于早期发展阶段，发展空间巨大，业内厂商均可以拥有充足的发展机遇。

	<p><b>7、请问公司认为国内 MEMS 产业以及 MEMS 工艺开发技术与国外存在哪些差距？</b></p> <p>答：长期以来，国内 MEMS 产业一直处于起步阶段，MEMS 产品的层次结构偏低，相关工艺开发技术也不够复杂全面，具有一定知名度和出货量的本土 MEMS 企业仍然屈指可数。与此同时，对比国外的巨头厂商及产业生态，国内 MEMS 产业的设计、制造和封装测试环节较为分散，不够均衡，未能形成完备的产业链体系与工艺技术体系，这方面也与国外存在一定差距。但是，我们也可以看到，在产业自身发展、内循环需求驱动的背景下，近年来在国内也纷纷涌现出一批代表性公司，在追赶国外厂商的同时，也在一些如通信、工业汽车等领域实现创新突破、积累并形成竞争优势。</p> <p><b>8、请问公司如何定位 2023 年新增的半导体设备业务？</b></p> <p>答：公司 2023 年新增的半导体设备业务为集团贡献了一定体量的营业收入以及部分盈利，对盈利的贡献金额较小。赛积国际作为公司 MEMS 封装测试业务的一级平台企业开展相关业务活动，同时兼顾支持公司旗下境内 MEMS 代工制造中试线；此外，由于公司基于建设“境内-境外双循环”代工服务体系的发展战略，在境内外拥有数条在建/运营/规划中的半导体制造产线，且考虑到复杂的国际政治经济环境，近年来公司旗下子公司从境外战略性采购了多批次半导体设备进行使用或储备，赛积国际根据公司业务发展的实际需要开展部分与半导体设备相关的保障业务，在服务集团旗下 FAB 需要的同时，也根据市场需求服务于其他半导体制造企业。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 6 月 28 日